

【原因・判断ポイント・発生工程】プッシュバック加工時の衝撃により、応力集中部に出来たもの(プッシュバック加工工程)

【原因、判断要点、发生工序】回压时的冲击在应力集中的部位所发生的(回压工序)。

【Causes/processes involved/keys to judgment】
The defect is caused by the stress concentration produced by push-back operation (Push-back process)



【コメント】
顕微鏡倍率×

【注釋】
显微镜倍率×

【Comments】
Magnification: ×

6-1-5 プレス抜きズレ／冲切的偏移 / Misalignment in punching

【特徴】打抜きプレス外形がズレている状態の欠陥

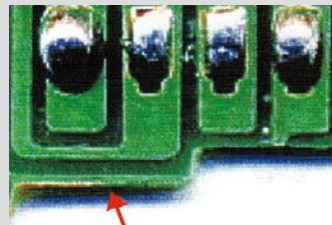
【特征】冲切外形偏移的缺陷。

【Characteristics】Punched board outline is displaced.

【原因・判断ポイント・発生工程】プレスガイドピンセッティングミス、基板の反りによるプレスガイドピンからの外れなどのまま打ち抜かれて出来たもの(打ち抜きプレス工程)

【原因、判断要点、发生工序】冲切导销の設定错误、或者板翘曲导致导销偏移等所引起的(冲切工序)。

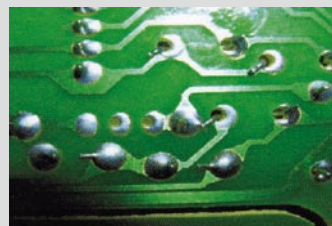
【Causes/processes involved/keys to judgment】
The defect is caused by a wrong setting of a press guide pin or coming-off of a board from the press guide pin due to board warping in punching (Punching process)



【コメント】
回路線が打ち抜かれ断線している
顕微鏡倍率×

【注釋】
线路被冲切的开路
显微镜倍率×

【Comments】
Conductor is punched off and broken.
Magnification: ×



【コメント】
顕微鏡倍率×

【注釋】
显微镜倍率×

【Comments】
Magnification: ×

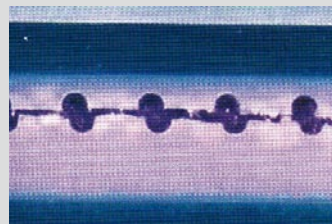
6-1-6 プレスミシン目割れ／邮票孔的爆裂 / Cracking along perforation

【特徴】打ち抜きプレス外形加工後の製品がミシン目に沿って割れている状態の欠陥

【特征】冲切外形后的产品沿着邮票孔裂开的缺陷。

【Characteristics】A punched product is cracked along perforation.

【原因・判断ポイント・発生工程】切れ味の悪い金型で打ち抜いた衝撃や、設計的に弱いミシン目部が打ち抜きプレス衝撃を受けたことにより出来たもの(打ち抜きプレス工程)



【コメント】
顕微鏡倍率×

【注釋】
显微镜倍率×

【Comments】
Magnification: ×